



连接器 > 插拔式连接器和笼子 > CFP/CFP2/CFP4



插拔式 I/O 产品类型: 附件

连接器系统: 缆到板

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

|              |       |
|--------------|-------|
| 外形尺寸         | CFP2  |
| 插拔式 I/O 附件类型 | 散热器卡箍 |
| 笼子类型         | CFP2  |
| 产品线          | CFP   |
| 插拔式 I/O 产品类型 | 附件    |
| 连接器系统        | 缆到板   |
| Sealable     | 否     |
| 连接器和端子端接到    | 印刷电路板 |

主体特性

|      |     |
|------|-----|
| 电镀材料 | 镍   |
| 材料   | 铝合金 |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 41.5 mm |
|----|---------|



|            |         |
|------------|---------|
| PCB 厚度（建议） | 3 mm    |
| 长度         | 82.4 mm |

操作/应用

|               |        |
|---------------|--------|
| 兼容的散热器        | 是      |
| 适用于插拔式 I/O 产品 | CFP 组件 |
| 电路应用          | Signal |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 盒和托盘 |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2274845-1  
CFP2 RECEPTACLE ASSEMBLY



TE 产品编号 2288218-3  
HEAT SINK,FRONT TO BACK  
AIREFLOW,CFP2



TE 产品编号 2288218-6  
HEAT SINK,FRONT TO BACK  
AIREFLOW,CFP2



TE 产品编号 2288219-3  
CFP2 HEATSINK, SIDE TO SIDE  
AIRFLOW



TE 产品编号 2288221-1  
CFP2 EMI/DUST PLUG

客户还购买了



TE 产品编号1-329631-2  
JAM NUT, PLATED



TE 产品编号1551920-4  
zQSFP+ connector assembly



TE 产品编号2-6450832-5  
MBXL R/A HEADER 5P+ 2LP + 24S



TE 产品编号NB11652001  
ATUM-6/2-0-STK



TE 产品编号1-2176380-3  
RQ 0805 1K54 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1888901-1  
SFP+ EMI Plug



TE 产品编号1888810-2  
EMI/Dust Cover,XFP And QSFP



TE 产品编号1775838-2  
mSATA/mini PCI-E 5.6H Type I G/F



TE 产品编号1932638-3  
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset

文档





产品图纸

CFP2 HEATSINK CLIP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2288220-2\_1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2288220-2\_1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2288220-2\_1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本